



Descripción del Producto

El adhesivo **TEKBOND - 200** es un adhesivo a base de cianoacrilato. Fue especialmente formulada para adhesiones entre superficies ásperas o irregulares que necesitan de alta viscosidad. Es un producto monocomponente y no necesita mezcla. El proceso de curado comienza cuando una fina camada de adhesivo es aplicada entre las superficies, entrando en contacto con la humedad del aire atmosférico. Puede ser usado en materiales que exijan relleno de holguras, pegando cauchos, plásticos, metales y otros sustratos. Indicado para componentes electrónicos, pues permite el reposicionamiento de las piezas.

Propiedades Físicas - Líquido

Base química:	Cianoacrilato de etilo
Apariencia (visual):	Líquido incoloro a levemente amarilleado
Viscosidad a 25°C:	1400 a 1800 cps
Densidad a 25°C:	1,04–1,06 g/mL
Punto de inflamación (TCC):	>80°C
Tiempo de almacenamiento a 6°C:	12 meses
Soluble en:	Mek, Acetona, Nitrometano.

Propiedades Físicas - Curado

Apariencia (visual):	Sólido Incoloro
Temperatura de operación:	-55 a 80 (°C):
Rellenado de holgura:	0,2 mm
Resistencia al corte:	≥ 100 (acero x acero) kgf/cm ²
Curado Total:	24 horas

Tiempo de curado en otros sustratos

Sustrato	Tiempo (segundos)	Sustrato	Tiempo (segundos)
Acero x Acero	≤ 50	PVC	≤ 30
Acero inoxidable	≤ 90	Cuero	≤ 40
Aluminio	≤ 30	Madera	≤ 45
Zinc	≤ 90	NBR x NBR	≤ 20
ABS x ABS	≤ 40	ABS x Madera	≤ 10
ABS x NBR	≤ 15	MDF x MDF	≤ 30

Nota: La velocidad de curado es influenciada por varios factores: el tipo de sustrato utilizado, las condiciones de la superficie, condiciones atmosféricas, limpieza, holguras entre las partes, etc.

Cuando el tiempo de curado es demasiado largo debido a las grandes holguras entre las partes o a la baja humedad relativa del aire, es necesario utilizar el *Acelerador QFS Tekbond* antes de aplicar el producto. Recomendamos la realización previa de pruebas para confirmación del resultado obtenido.

Instrucciones de uso y manejo

Para obtener un resultado satisfactorio, las superficies deben estar limpias, libres de aceite y suciedad. Se debe aplicar una camada fina de adhesivo en sólo 1 (uno) de los sustratos que serán pegados, porque el exceso perjudica el buen desempeño del pegado.

Después de la aplicación del adhesivo, las piezas deben ser mantenidas presionadas por aproximadamente 20 segundos, cuando el curado inicial esté completo y la pieza pueda ser manejada con seguridad. El curado total sucederá en 24 horas.

Este adhesivo es indicado para holguras de hasta 0,2 mm.

Si es necesaria la limpieza del exceso de adhesivo, esto debe ser realizado con acetona o MEK (metil etil cetona).

No se adhiere a plásticos a base de poliolefinas (PP), silicona y Teflon* (*marca registrada Dupont). Para esa adhesión, utilice el Primer poliolefínico TEK BOND.

Para el manejo del producto, se recomienda el uso de EPP. Para mayores informaciones de seguridad, consulte la FISPQ del producto.

Instrucciones de almacenamiento

Cuando el almacenamiento de los productos sea a corto plazo, recomendamos mantenerlos en lugar seco y bajo refrigeración entre 2°C y 21°C para envases sellados. Después de abrir el embalaje, recomendamos dejarlo bajo refrigeración para prolongar su vida útil. La condición ideal de almacenamiento es obtenida entre 3°C y 6°C, con mantenimiento en ambientes secos. Producto no inflamable.

Informaciones generales

Evite el contacto entre el producto y el agua, pues ocurrirá reacción exotérmica (con liberación de calor) y en grandes cantidades formará gases tóxicos e irritantes, pudiendo causar quemaduras en contacto con la piel y ojos. No inhale el adhesivo cianoacrilato, ya que es una sustancia irritante.

En caso de derrames o fugas, tire agua a una distancia segura, espere 30 minutos y después de este tiempo raspe el local con un objeto puntiagudo o una espátula metálica. No limpie con tejido o papel absorbente.

No recomendamos el uso del adhesivo instantáneo en ambientes muy húmedos, ya que la adhesión puede verse comprometida.

Envases disponibles

Tekbond ofrece frascos de 20g, 50g, 100g, 500g, 1Kg y 25Kg.



FICHA TÉCNICA TEKBOND 200

Publicada en:
11/2011

Revisada en:
08/2016

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.